



平成28年3月24日

各 位

会社名 芝浦メカトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤田 茂樹
(コード番号 6590 東証第1部)
問合せ先 常務取締役 経営管理本部長
道嶋 仁
(TEL 045-897-2425)

平成28年3月期 業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成27年4月23日に公表しました業績予想および平成27年9月24日に公表しました配当予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成28年3月期 連結業績予想の修正について

(1) 通期 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	47,000	1,400	1,200	800	16円19銭
今回修正予想(B)	45,300	1,100	1,000	700	14円17銭
増減額(B-A)	1,700	300	200	100	
増減率(%)	3.6	21.4	16.7	12.5	
(ご参考) 前期実績	43,799	1,021	1,138	697	14円11銭

(2) 業績予想修正の理由

第4四半期に入り、モバイル機器用半導体の後工程の顧客の設備導入ペースが鈍化したことと、一部顧客での発注・検収手続きの遅れがあったこと等により、半導体製造装置を中心に今年度の売上高が予想を下回る見込みとなり、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益も予想を下回る見込みとなりましたので、業績予想を修正いたします。

2. 配当予想の修正について

(1) 配当予想の内容

基準日	1株当たりの配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想(平成27年9月24日)			
今回予想		4円00銭	4円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績(平成27年3月期)	0円00銭	3円00銭	3円00銭

(2) 配当予想修正の理由

前回予想(平成27年9月24日)は配当予想を未定としておりましたが、当該事業年度の業績および剰余金の状況について一定の見通しを得ることができましたので、当社の配当方針である「配当性向25%程度」を基準として、配当予想を修正いたします。

(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以上